

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年9月17日(2015.9.17)

【公表番号】特表2014-524664(P2014-524664A)

【公表日】平成26年9月22日(2014.9.22)

【年通号数】公開・登録公報2014-051

【出願番号】特願2014-525044(P2014-525044)

【国際特許分類】

H 01 L 21/683 (2006.01)

H 01 L 21/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 N

H 01 L 21/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年7月30日(2015.7.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板支持体であって、

基板が第1の部材の第1の表面の上方に存在する場合に前記基板に対して熱を分配するための第1の部材と、

前記第1の部材に対して結合され、かつ前記第1の部材に対して熱を供給するために1つまたは複数の加熱ゾーンを有する、ヒータと、

前記第1の部材の下方に配設された第2の部材と、

前記第1の部材と前記第2の部材との間に配設され、前記第1の部材と前記第2の部材との間に隙間を形成する、管状本体と、

前記第1の部材の前記第1の表面の上方に第1の距離を置いて配設され、基板が前記基板支持体の上に存在する場合には前記基板の裏側表面を支持する、複数の基板支持ピンとを備える、基板支持体。

【請求項2】

基板支持体であって、

基板が第1の部材の第1の表面の上方に存在する場合に前記基板に対して熱を分配するための第1の部材と、

基板が前記基板支持体の上に存在する場合に前記基板の裏側表面を支持するために、前記第1の部材の前記第1の表面から延在する、複数の基板支持ピンと、

前記第1の部材内に配設された1つまたは複数の抵抗加熱要素と、

前記第1の部材の下方に配設された第2の部材と、

前記第1の部材と前記第2の部材との間に配設され、前記第1の部材の下部表面と前記第2の部材の上部表面との間に隙間を形成する、管状本体とを備える、基板支持体。

【請求項3】

基板支持体であって、

基板が第1の部材の上部表面の上方に存在する場合に前記基板に対して熱を分配するための第1の部材と、

基板が前記基板支持体の上に存在する場合に前記基板の裏側表面を支持するために、前記第1の部材の表面から延在する、複数の基板支持ピンと、

1つまたは複数の抵抗加熱要素をそれぞれが有し、前記第1の部材の下部表面上に配設される、1つまたは複数の加熱ゾーンと、

前記第1の部材の下方に配設された第2の部材と、

前記第1の部材と前記第2の部材との間に配設され、前記第1の部材の前記下部表面と前記第2の部材の上部表面との間に間隙を形成する、管状本体とを備える、基板支持体。

#### 【請求項4】

前記第1の部材の前記第1の表面から、および前記複数の基板支持ピンの周囲に延在する、アラインメントガイド

をさらに備える、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の基板支持体。

#### 【請求項5】

前記第2の部材中の開口に対して結合されるフィードスルーアセンブリであって、前記間隙から分離された容積部を有し、前記容積部の雰囲気は、前記間隙の雰囲気に対して独立して制御可能である、フィードスルーアセンブリ

をさらに備える、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の基板支持体。

#### 【請求項6】

前記第1の部材は、

前記第1の部材内に配設され、前記間隙に対して前記第1の部材の前記第1の表面を流体結合する、1つまたは複数のバージガスチャネル

をさらに備える、請求項5に記載の基板支持体。

#### 【請求項7】

前記複数の基板支持ピンのそれぞれが、前記第1の部材の前記第1の表面から延在する、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の基板支持体。

#### 【請求項8】

前記第1の部材および前記第2の部材は、前記管状本体に対して焼結される、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の基板支持体。

#### 【請求項9】

前記第1の部材の前記第1の表面上に配設された支持体層であって、前記複数の基板支持ピンのそれぞれが前記支持体層の表面から延在する、支持体層

をさらに備える、請求項1ないし3のいずれか一項に記載の基板支持体。

#### 【請求項10】

前記ヒータは、

複数の抵抗加熱要素をさらに備え、前記1つまたは複数の加熱ゾーンのそれぞれが、1つまたは複数の抵抗加熱要素を備える、請求項1に記載の基板支持体。

#### 【請求項11】

前記第1の部材の下方におよび前記管状本体の上方に配設された第3の部材

をさらに備え、前記複数の抵抗加熱要素がそれぞれ、前記第3の部材内に配設される、請求項10に記載の基板支持体。

#### 【請求項12】

前記複数の抵抗加熱要素がそれぞれ、前記第1の部材内に配設される、請求項10に記載の基板支持体。

#### 【請求項13】

前記複数の抵抗加熱要素がそれぞれ、前記第1の部材の下部表面上に配設され、

前記基板支持体が、絶縁材料を含むコーティングをさらに備え、前記コーティングが、前記第1の部材の前記下部表面上に配設された前記複数の抵抗加熱要素を覆う、請求項10に記載の基板支持体。

#### 【請求項14】

前記1つまたは複数の抵抗加熱要素は、複数の抵抗加熱要素を備え、前記複数の抵抗加

熱要素は、1つまたは複数の加熱ゾーン内に配置される、請求項2に記載の基板支持体。

【請求項15】

絶縁材料を含むコーティングをさらに備え、前記コーティングが、前記第1の部材の前記下部表面上に配設された前記1つまたは複数の抵抗加熱要素を覆う、請求項3に記載の基板支持体。